



## Ecco perchè Ivy Bridge scalda più del previsto



**LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/4583/ecco-perche-ivy-bridge-scalda-piu-del-previsto.htm>)**

Svelata una delle possibili cause dell'anomalo calore prodotto dalle CPU Ivy Bridge in condizioni di overclock.



↔

Gli appassionati di overclock che hanno avuto la possibilità di provare gli Engineering Sample di Ivy Bridge sono tutti concordi nell'affermare che il nuovo processore, contrariamente a quanto si potesse pensare, scalda più del previsto.

Una ricerca condotta da Overclockers.com ha rivelato un possibile fattore che potrebbe esserne la causa.

Gli addetti ai lavori hanno infatti rimosso l'IHS di un esemplare di Ivy Bridge e hanno scoperto che, tra il silicio del processore e la placchetta metallica su cui andiamo ad appoggiare i dissipatori, esiste uno strato di comune pasta termica.

Ricordiamo ai lettori che Intel, per i processori con architettura Sandy Bridge, aveva utilizzato una vera e propria saldatura tra l'IHS ed il blocco in silicio che, oltre a rendere quasi impossibile la rimozione della placca metallica senza rischiare di danneggiare il processore, contribuiva a migliorare lo scambio termico tra i due componenti.

Nei nuovi processori l'utilizzo della pasta termica sicuramente peggiora lo scambio termico con conseguente innalzamento della temperatura dei core ma, allo stesso tempo, permette una più facile e sicura rimozione dell'IHS.

Questa scelta di Intel sicuramente non farà piacere alla stragrande maggioranza degli utenti che si ritroveranno in mano delle CPU a 22 nm che, in overclock, possono scaldare più delle controparti Sandy Bridge; diversamente, può essere una mossa molto apprezzata dagli overclockers estremi, i quali possono beneficiare della possibilità di rimuovere l'IHS, anche correndo il rischio di scheggiare il silicio con grande facilità .

↔

↔